

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

广州方邦电子股份有限公司

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“方邦股份”或“公司”）根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”），具体内容如下：

一、公司的主营业务

公司成立于 2010 年，是一家集研发、生产、销售和服务为一体的高端电子材料及解决方案供应商。目前，公司的主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售，专注于提供高端电子材料及应用解决方案。公司现有产品包括电磁屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔等，属于高性能复合材料，主要产品包括屏蔽膜 HSF-6000 系列、屏蔽膜 HSF-USB3 系列、有胶三层挠性覆铜板（3L-FCCL）、无胶两层挠性覆铜板（2L-FCCL）系列和可剥离极薄铜箔系列等，广泛应用于智能手机、平板电脑、移动通讯设备、可穿戴设备等电子科技产品。自成立以来，公司一直专注于电磁屏蔽等电子材料技术的研究和应用，力求开发具有市场竞争力的产品，为客户提供优质的产品和完善的服务，从而保持并提高企业的核心竞争优势。经过多年发展，公司已经成为国内技术领先规模最大的电磁屏蔽膜生产制造服务商。

公司凭借出众的产品性能、持续的技术创新以及快速的服务响应，积累了鹏鼎、MFLEX、弘信、景旺、BHflex 等众多优质直接客户，并与华为、小米、OPPO、VIVO、三星等知名终端客户保持密切的技术交流与合作，在电磁屏蔽膜、极薄挠性覆铜板、超薄铜箔等细分领域的影响力不断提升。

二、本次募集资金投向方案

（一）本次募集资金的使用计划

本次发行计划募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	电阻薄膜生产基地建设项目	15,600.00	15,600.00
2	补充流动资金	14,400.00	14,400.00
合计		30,000.00	30,000.00

本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自有资金或自筹解决。

若本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额因监管政策变化或根据注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。公司已建立募集资金管理制度，本次向特定对象发行募集资金将存放于公司指定的专项账户中。

（二）募集资金投资项目基本情况及可行性分析

1、电阻薄膜生产基地建设项目

（1）项目概况

本项目将通过在已有地块上新建生产基地，投入业内先进自动化生产设备，引进业界精英人才，扩大电阻薄膜产品产能，从而满足公司未来在高端电子材料市场快速增长的需求。该系列产品为公司最新研制成功的自主研发型产品，该产品将广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品领域，同时，

将有效完成现有产品结构的调整和优化，进一步丰富产品类型，提升公司的主营业务规模和综合竞争实力，巩固和提升公司在电子材料领域技术领先的优势地位。因此，本项目的实施有利于公司抓住市场发展黄金机遇，扩大公司核心产品生产规模、拓宽产品的规格种类，完善产品结构，提高公司实力和竞争力，满足公司业务发展的需要。

（2）项目建设的必要性

①推进电阻薄膜的国产化，符合国家长期发展战略

目前，电阻薄膜作为新一代的高端电阻产品，其制造技术主要控制在国外厂商手中，具备电阻薄膜材料生产制造能力和相关知识产权的国内厂商较少。国内消费电子行业厂商采购生产所需的电阻薄膜材料均产自 Ohmega Technologies、Ticer Technologies 等国外厂商。

公司自主研发的电阻薄膜产品，主要应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品领域，产品目前已完成样品试制，客户测试认证正在进行中，在国内该领域享有领先优势。因此，本项目的实施将有利于推动国产电阻薄膜领域的发展，促进我国高端被动元器件产品的生产自主可控与供应链安全保障，符合国家长期发展战略。

②提高公司实力和竞争力，满足公司未来发展需要

公司成立于 2010 年，得益于全球手机、电脑、平板电脑等消费电子产品的快速普及应用，带来了电磁屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔等高端电子材料需求高速增长，同时公司凭借优质的产品性能、稳定的客户基础以及快速的客户反应能力，近年来公司销售额总体有所增长。目前，公司已成为了全球电磁屏蔽膜龙头企业之一，亦是国内技术领先、规模最大的电磁屏蔽膜生产制造服务商。

本项目将通过在已有地块上新建生产基地，投入业内先进自动化生产设备，引进业界精英人才，扩大电阻薄膜产品产能，从而满足高端电子材料市场快速增长的需求。同时，本项目实施将进一步调整和优化公司产品结构，丰富产品类型，提升公司的主营业务规模和综合竞争实力，巩固和提升公司在电子材料领域技术领先的优势地位。因此，本项目的实施有利于公司抓住市场发展黄金机遇，扩大

公司核心产品生产规模、拓宽产品的规格种类，完善产品结构，提高公司实力和竞争力，满足公司业务发展的需要。

③使公司现有客户资源得到更有效的综合利用

公司自设立以来一直从事电子材料的生产、研发、销售与服务，主要生产应用于消费类电子终端设备零部件中的电磁屏蔽膜、挠性覆铜板、极薄电解铜箔等产品，公司所属行业的销售模式一般是，电子材料供应商首先需要通过消费类电子产品终端客户的认可，由终端客户向其代工厂或者零部件生产加工厂家指定采购已经认可的电子材料。经过多年的发展，公司通过屏蔽膜业务的快速发展积累了三星、华为、小米、VIVO、OPPO 等众多国内外知名的终端客户群以及景旺、弘信、维信、美维、臻鼎、新宇、上达、三星电机、BHFlex 等一批优质的直接下游客户。

而电阻薄膜与屏蔽膜、挠性覆铜板等产品下游需求客户为同一客户群，客户资源协同效应巨大。本项目建成以后，将为终端客户的配套零部件厂商提供电阻薄膜产品，既有利于为客户提供丰富的产品配套服务又有助于提高公司的客户资源利用效率，使得公司在较低客户获取成本水平的基础上扩大整体业务规模，从而产生巨大的客户资源协同效应。因此，本项目是在公司现有的资源基础上进行，将使得公司的现有客户资源得到更加有效的综合利用。

（3）项目建设的可行性

①消费电子行业市场规模稳定增长将提供广阔市场空间

未来国产被动元器件高端产品逐步实现进口替代及全球智能手机、平板电脑、可穿戴设备市场仍将保持平稳增长等因素，将推动国产电阻薄膜产品进口替代进程，带来其渗透率的不断提升，实现市场规模的快速增长。与此同时，随着电阻薄膜对传统表面贴装电阻器件的逐步替代，成为全球电阻产业的下一代主要产品，其市场前景极其广阔。以上因素将为本项目的实施提供了良好的支持。

②领先的技术实力及强大的研发团队为本项目的顺利实施提供了技术基础

公司多年来专研电子材料应用和印刷线路技术，以市场需求为导向，积极开

拓印刷线路板市场。公司多年来一直坚持自主研发理念，开发了磁控溅射设备、连续卷式电镀设备，掌握了精密涂布技术以及配方合成技术，在制程工艺上已经走向成熟阶段。针对电阻薄膜材料，公司打造了与目前的制程匹配兼容的专业工艺路线，优化材料选择，根据客户需求提供多种方案。公司生产的电阻薄膜材料，具有均匀的方阻值，高剥离强度以及稳定的环境可靠性，基本满足国内外产品需求。另外，公司建立了专业的检测平台，拥有多种大型检测仪器和设备，从材料的形貌结构、物理性能和化学性能，实现对材料的全方位测试。为了进一步提高内部研发水平，公司不断招揽高端人才，打造出一支具备线路板行业技术和管理先进理念的人才队伍，增大对研发的投入力度。目前，公司注重科学技术发展，在电子材料领域布局了多方位专利，覆盖了电磁屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔和电阻薄膜等多领域。公司始终致力于高质量、高水平的发明专利，营造雄厚的产品知识产权基础实力。因此，公司现有的技术研发能力和质量管理经验，将为本项目的实施提供有力保障。

③成熟的配套设备工艺流程及制造管理体系保障了本项目的顺利实施

经过多年生产实践的摸索，公司完成了涂布设备、溅射设备、电镀设备等相关设备的自主设计研发与调试，并在生产过程中不断对设备参数（温度、压力等参数）、化学制剂配方（制剂用量和比例）进行调整和测试，并不断调整与之相适应的生产工艺技术与流程。公司于 2011 年成功开发出电磁屏蔽膜产品，经过多年生产经营，公司已经摸索出一条稳定且高效的“设备、工艺技术、化学制剂配方”相互匹配的生产工艺流程。而电阻薄膜材料的主要工艺流程与屏蔽膜产品有诸多共通之处，能有效利用公司多年的工艺与技术积累。

与此同时，公司还制定了《采购和外包过程控制程序》、《生产过程控制程序》、《出货管控流程》、《不合格品控制程序》、《客诉处理流程》等制度文件，对产品的原料采购、生产、销售、服务进行了严格的程序化、流程化管理，以确保质量管理体系的持续性和有效性。因此，成熟的配套设备工艺流程及制造管理体系保障了本项目的顺利实施。

④稳定的核心人才保障本项目人才队伍的快速有效建立

公司已经培养、储备了一支有着丰富的行业运作经验的管理团队，在业务开

拓、品牌形象树立、技术团队建设、市场营销、内部风险控制等公司的运营环节层层把关，形成了行之有效的、完善的内部控制制度，取得较好的管理效果，促进公司建立了竞争优势。

公司具有一批专业性强、知识结构丰富的技术人才及经验丰富的管理人才，是公司本项目成功实施的重要保障。目前，公司正在制定与项目建设进度相配套的人员招聘及培训计划，并将依照项目规划按时实施。

（4）项目实施主体和投资概况

本项目的实施主体为广州方邦电子股份有限公司，项目总投资额为 15,600.00 万元，拟使用募集资金金额为 15,600.00 万元，项目计划建设期为 21 个月。

（5）项目备案与环境保护评估情况

截至本预案公告日，本项目已于 2021 年 4 月 8 日在广东省发展和改革委员会完成备案，并获取《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2104-440112-04-01-868265）。环评手续正积极推进中。

2、补充流动资金

公司本次发行股票，拟使用募集资金 14,400.00 万元用于补充流动资金。本公司以实际经营情况为基础，综合考虑了公司现有的资金情况、资本结构、运营资金需求缺口与未来战略发展目标，适量补充流动资金，以优化资本结构并满足公司未来经营发展需求。

（1）补充流动资金的必要性分析

①为公司业务发展提供重要的资金保障

近年来公司业务稳步发展，公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的营业收入分别为 27,470.74 万元、29,169.38 万元和 28,853.61 万元，分别同比增长 6.18%和 -1.08%，2020 年度受全球新冠疫情不利因素的影响，公司经营业绩基本稳定。基于信息技术行业技术升级与行业需求稳步增长以及国产化加速的背景，

公司所在电子专用材料制造行业将迎来更大的市场机遇。为保持并加强竞争优势，公司需要在研发和制造等各个环节持续进行资金投入，以跟随市场完成产品的升级换代。同时，未来随着公司积极进行市场开拓，业务规模与产品类型将不断扩张，公司流动资金的需求将不断加大。因此，本次向特定对象发行股票募集资金补充公司流动资金，能有效缓解公司的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切实保障。

②优化公司财务结构，增强公司抗风险能力

公司的客户主要为 FPC 厂商，终端应用行业主要为消费电子行业、汽车电子行业和通信行业，其中以消费电子行业为主。受益于 5G 通讯、汽车电子等行业的快速发展，下游客户需求虽然中长期保持增长态势较好，但不排除阶段性地受宏观经济政策、下游行业产能投资周期、技术发展变化、消费者偏好等因素影响而存在波动的风险。本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，可进一步优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保障公司的持续、稳定发展。

（2）补充流动资金的可行性分析

①募集资金用于补充流动资金符合法律法规的规定

公司本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金，有利于增强公司资本实力，提升公司在技术、生产等方面的市场竞争力，长期看将有利于增强公司持续盈利能力。

②募集资金管理与运用相关的内控制度完善

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司已根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件制定了《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督进行了明确的规定。本次募集资金将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理，专款专用，规范使用募集资金。

三、本次募集资金投向属于科技创新领域

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目为电阻薄膜生产基地建设项目及补充流动资金。本次募投项目旨在丰富公司现有产品品类，提升公司在新一代信息技术产业和高端电子元器件制造领域的竞争力与科技创新水平，服务于国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。

电子元器件行业作为基础性产业，是支撑信息技术产业发展的基石，同时也是，也是保障产业链和供应链安全稳定的关键。2021年1月，工信部发布了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，提出实施重点产品高端提升行动，面向电路类元器件等重点产品，突破制约行业发展的专利、技术壁垒，补足电子元器件发展短板，保障产业链供应链安全稳定，实现攻克关键核心技术的目标。电阻薄膜为电阻行业技术发展的主要方向之一，随着消费电子设备的轻薄化的趋势，具有节省线路板空间、可靠性更高的电阻薄膜将得到进一步广泛应用。本次募集资金主要投向属于国家行业政策重点支持发展的科技创新领域。

（二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

通过本次募投项目的实施，公司将提升在高端电子元器件领域的竞争力，加强研发与技术转化能力，提高公司整体业务规模，进一步加强公司核心竞争力，持续提升公司的科技创新实力。

未来公司将围绕自身的核心优势、强化管理及结合内外部资源，不断推动企业发展，面向国家重大需求和客户需求，不断提高关键技术水平，优化产品工艺，最终成为国内领先、国际知名的高端电子元器件及高端电子材料产品与解决方案供应商。

四、结论

综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向方案中所列示两项募集资金投向均属于科技创新领域，均有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定的要求。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 2 日